



# 微小領域薄膜X線回折

数百  $\mu\text{m}$  の微小な領域の、数十nmの薄膜の結晶構造分析が可能です。

## 用途

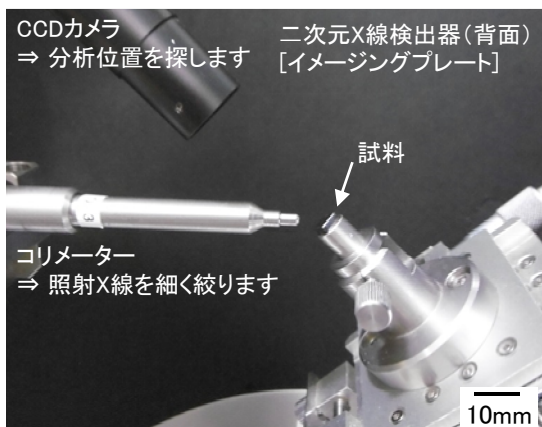
- **ピンポイント分析**  
試料中の局所的な分析領域を狙ってX線回折測定ができます。
- **採取困難なサンプルの分析**  
量が少なく、厚さが非常に薄くて採取できないサンプルも、そのまま直接X線回折測定ができます。
- **種々の物質が混在したサンプルの分析**  
複数の物質が混在しても高精度に結晶構造の同定ができます。

## 特徴

- **細く絞った照射X線とイメージングプレートによる微小領域の高感度分析**  
数百  $\mu\text{m}$  の微小領域のX線回折測定が可能です。
- **X線低角入射による試料表層部の高感度分析**  
数十nm厚さの薄膜のX線回折測定が可能です。低角度領域の回折ピーク検出により、解析精度が向上しました。  
⇒ 従来では検出が困難だった、微小領域かつ薄膜のX線回折測定が可能です。

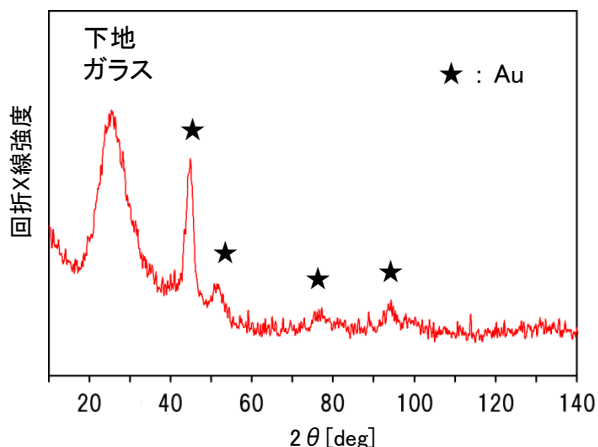
## 応用例

### ● 測定光学系



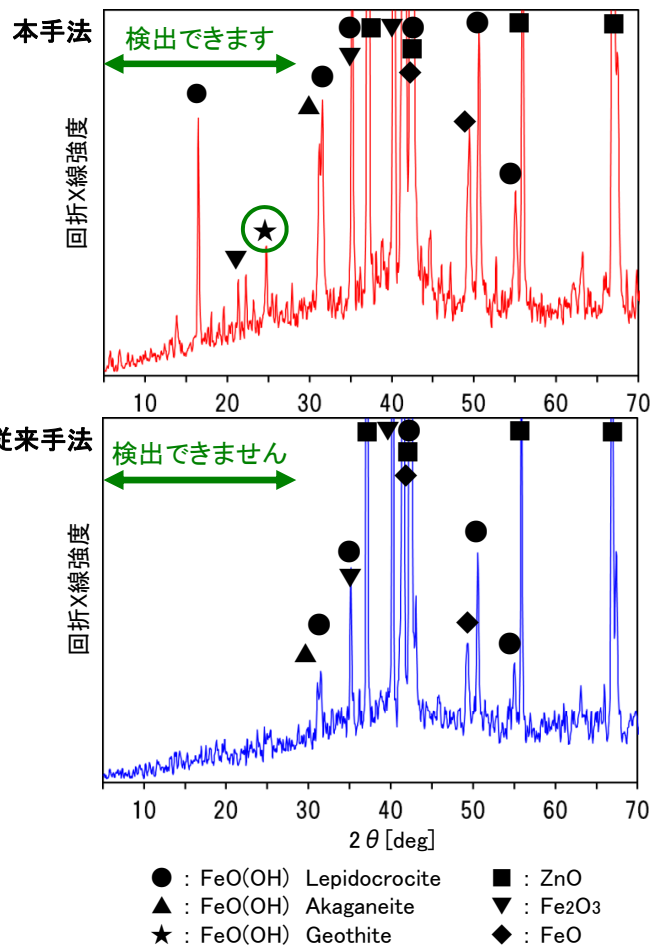
### ● 金(Au)蒸着膜の測定

ガラス上に蒸着したAu(厚さ約30nm)も測定できます。



### ● さびの測定

低角度領域の回折ピークの検出が可能になり、従来より精度の高い解析で物質の同定ができます。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2017 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.  
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。